

台亞半導體股份有限公司

2022年法人說明會

2022/11/22

免責聲明

- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

公司概況

關於台亞



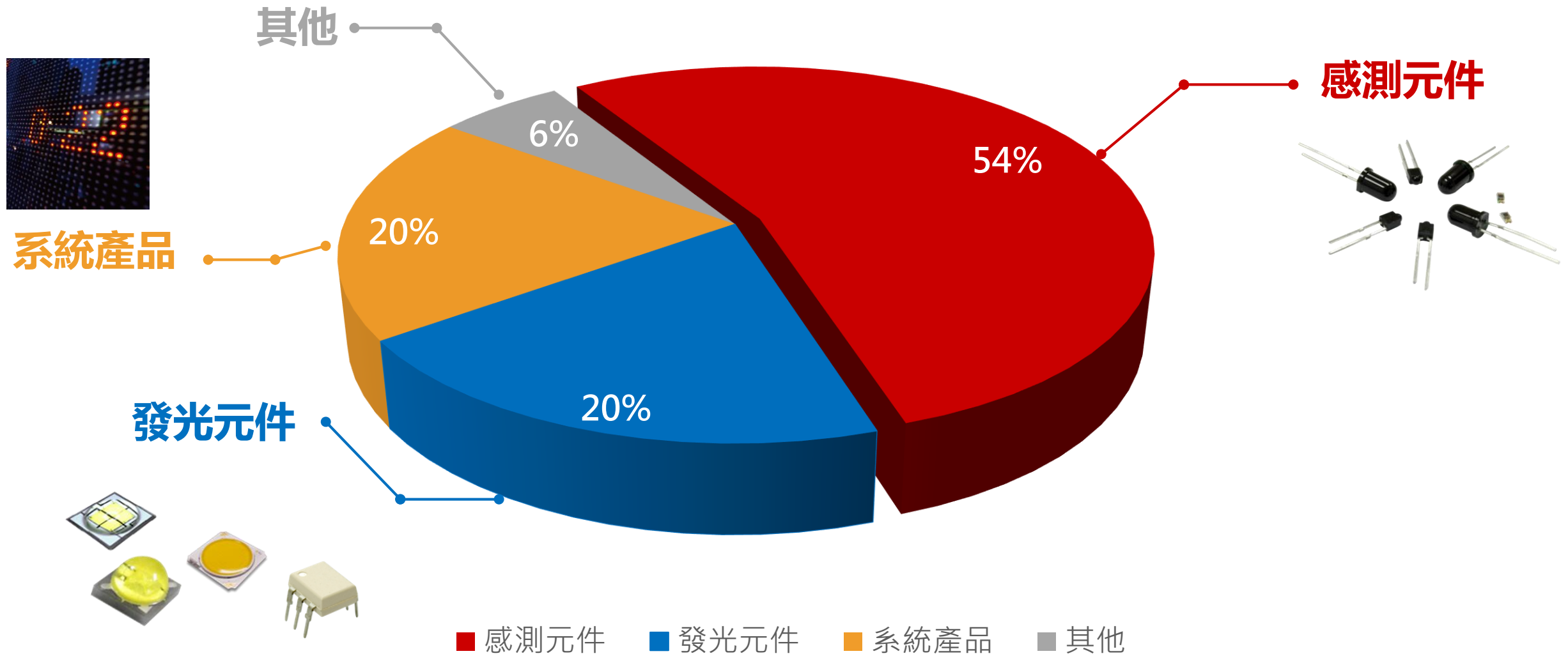
2021.11月
更名為台亞半導體股份有限公司
原名 光磊科技股份有限公司

2022.3月
成立子公司-「積亞半導體股份有限公司」

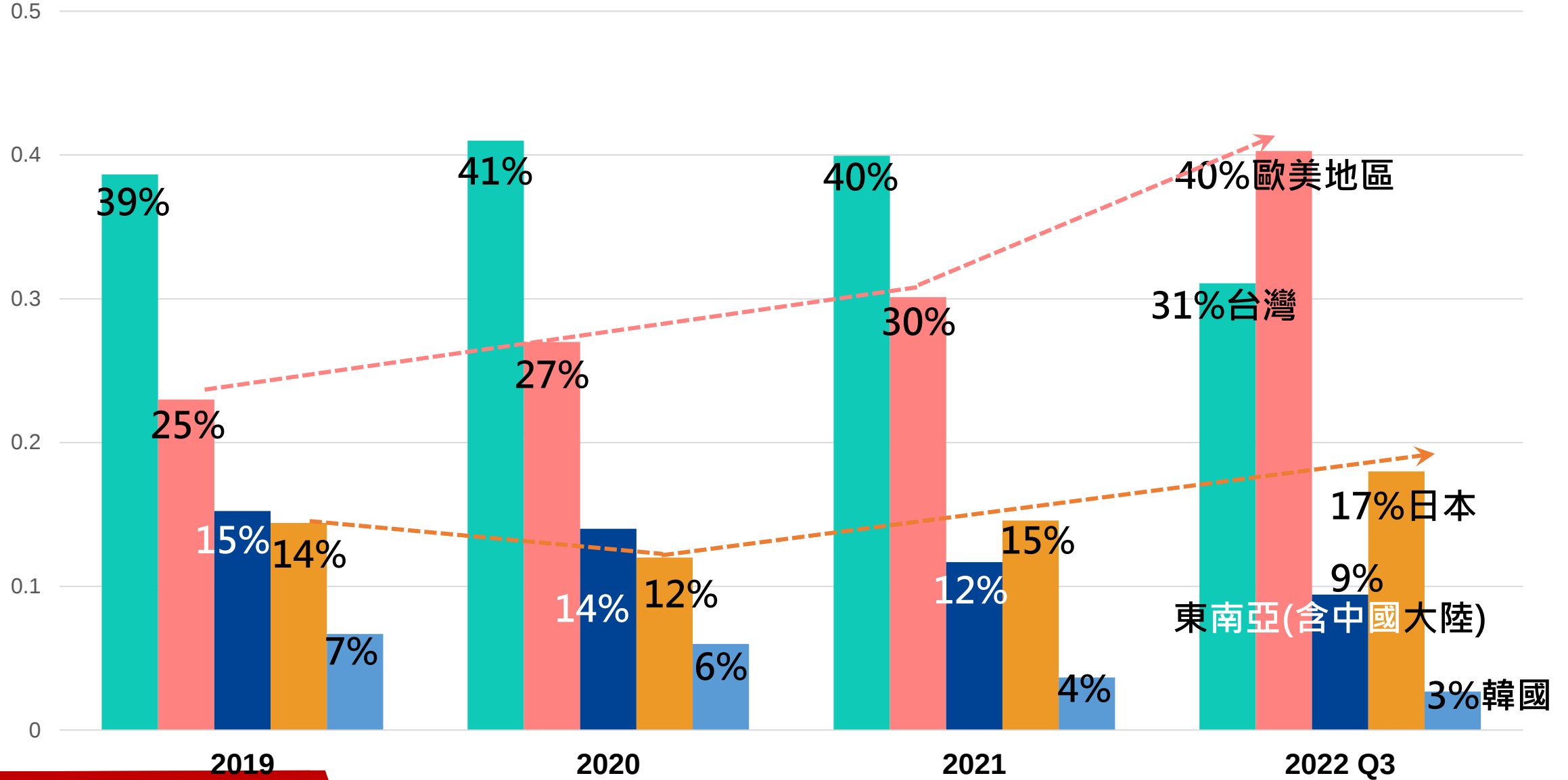
2022.1月
分割系統事業群
成立子公司「光磊先進顯示科技股份有限公司」

2022.11月
投入第三代半導體產品

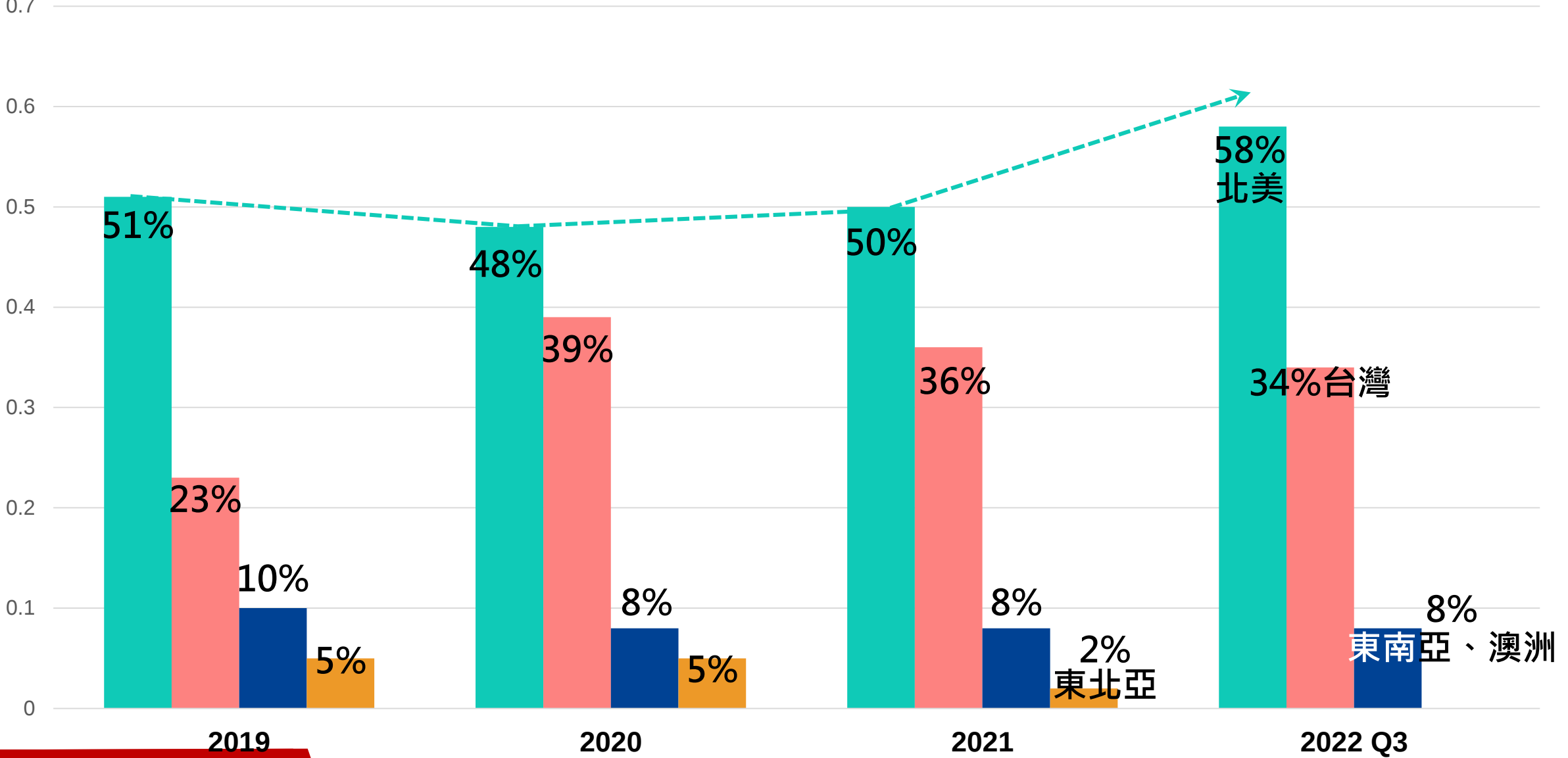
集團產品



產品銷售區域-發光元件及感測元件



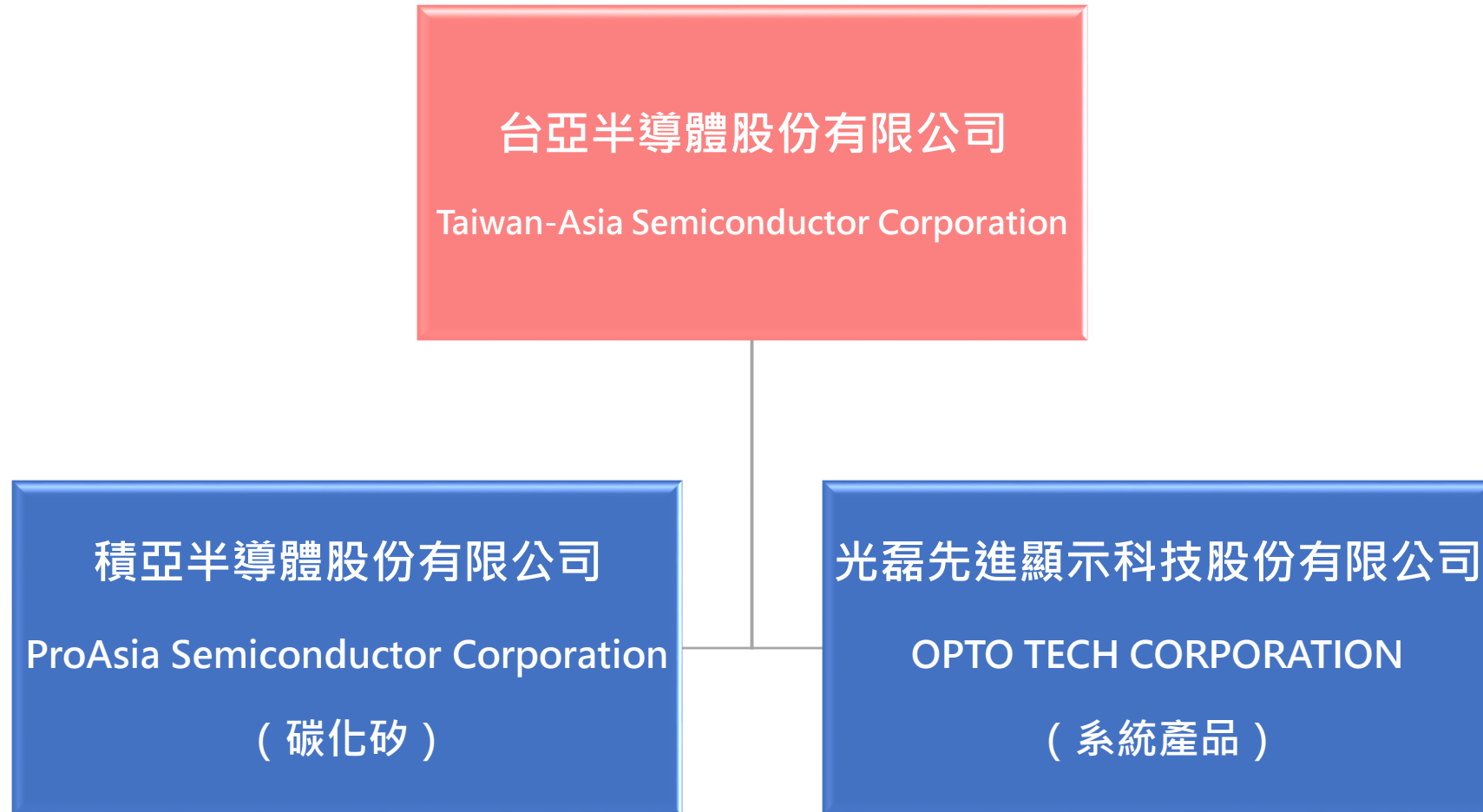
產品銷售區域-系統產品



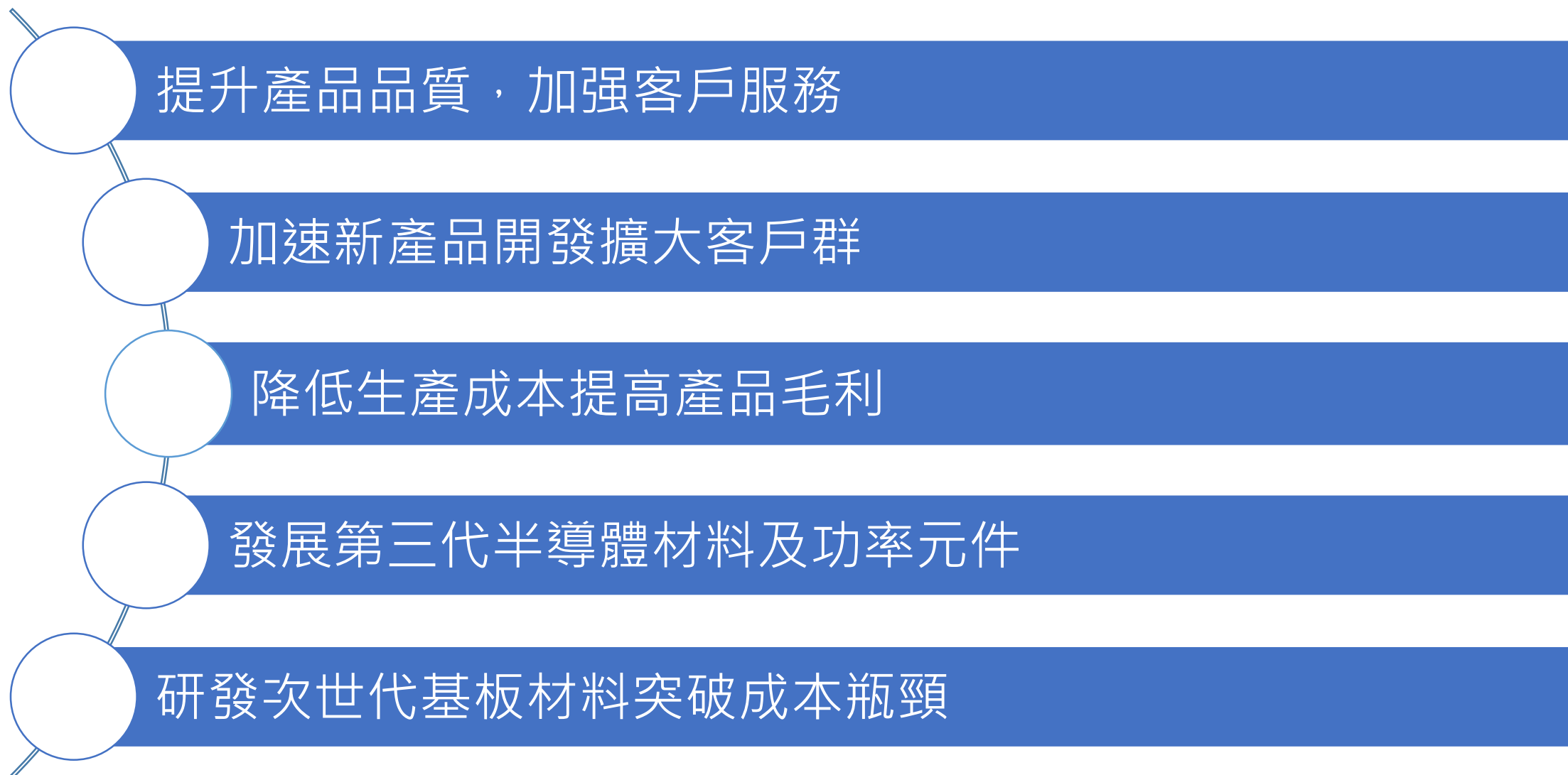
公司策略方向及未來展望

- 經營策略、產品應用、市場趨勢、新產品規劃

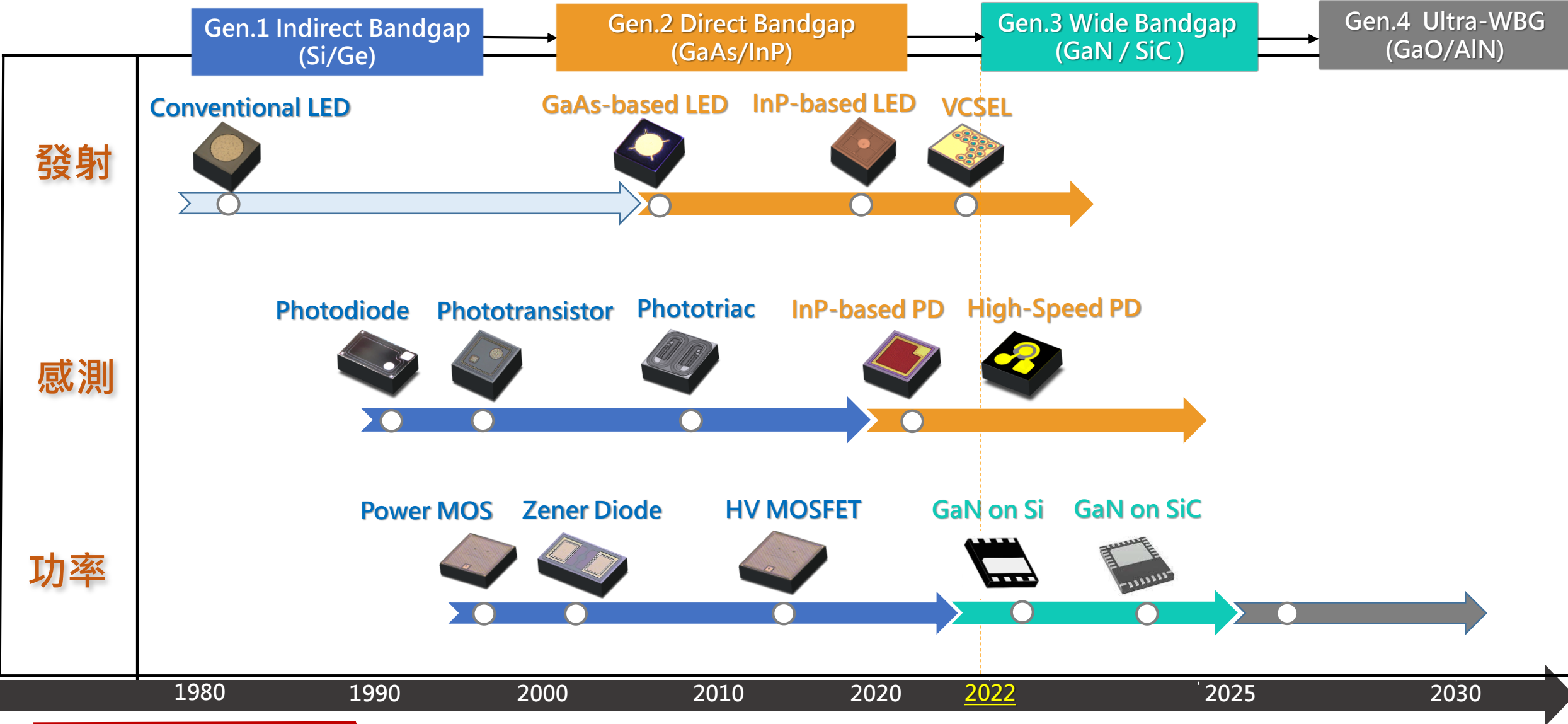
投資架構



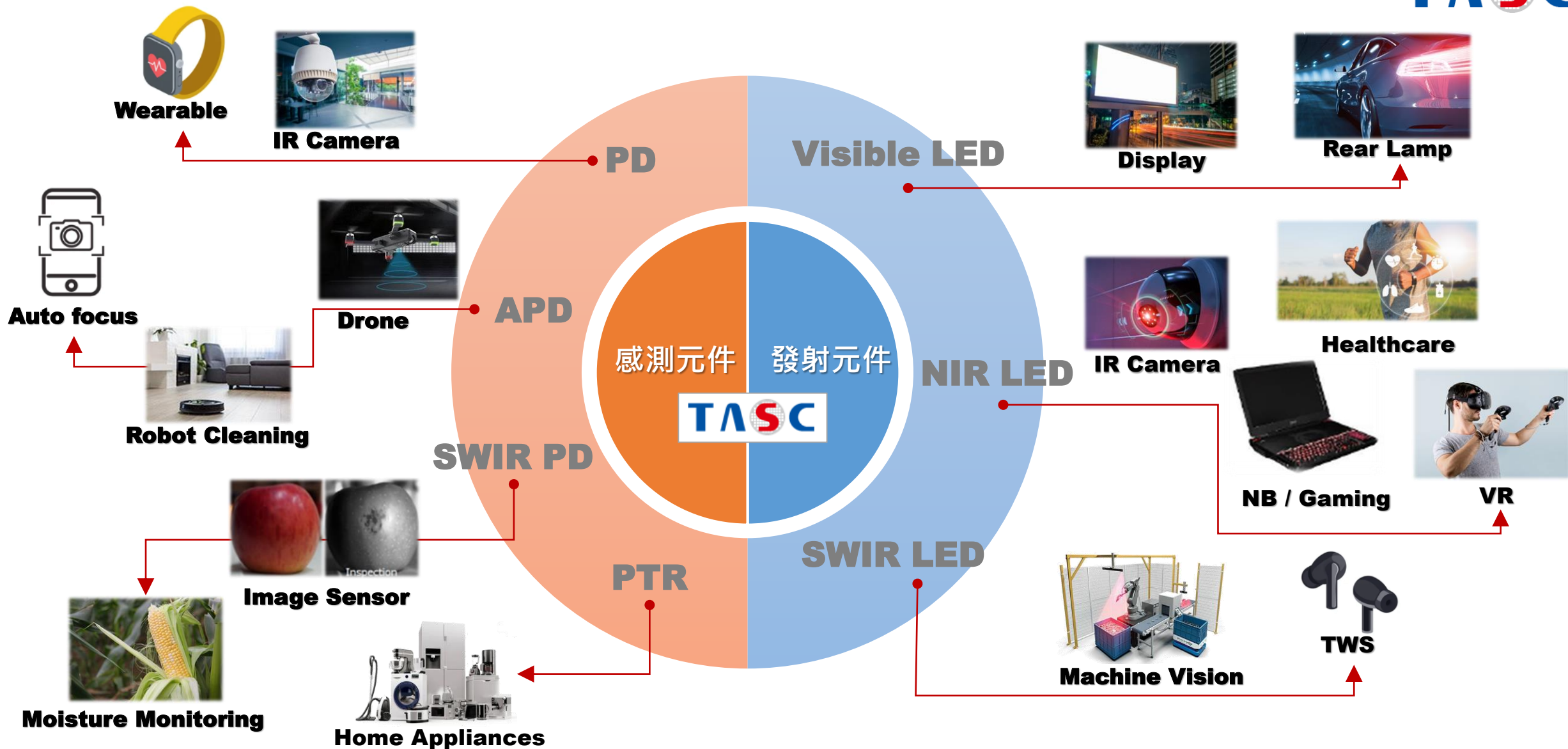
台亞半導體公司經營策略



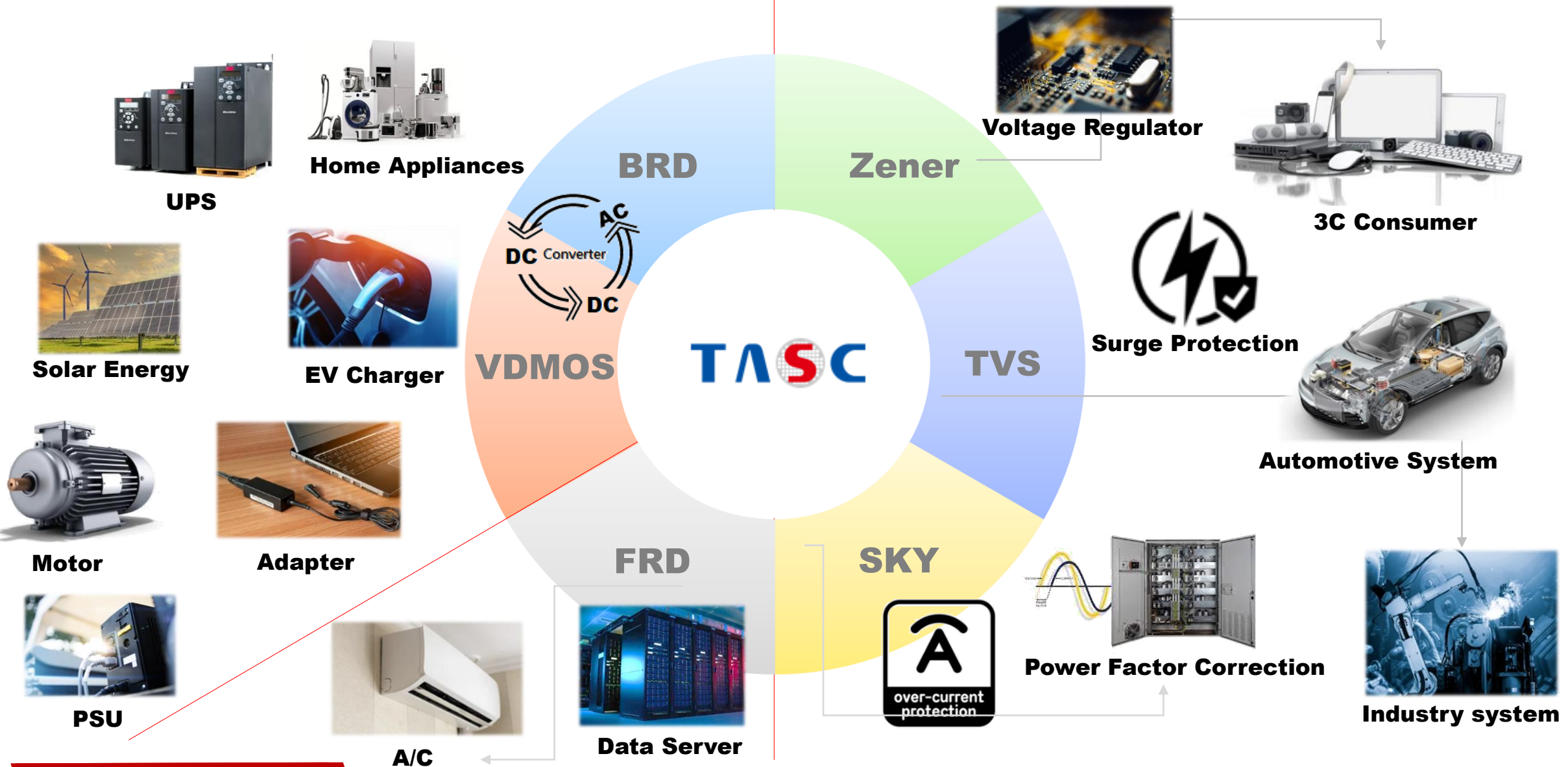
台亞集團三大產品發展路線圖



感測與發射元件應用市場

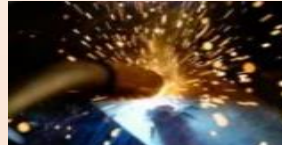


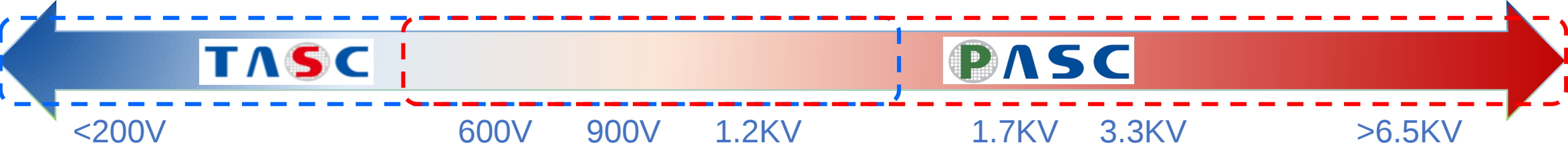
功率元件應用市場



GaN-on-Si 和 SiC 產品應用



 Fast Charger	 Lighting Driver	 EV OBC	 Motor	 EV Charger	 Wind Energy	 Smart Power Grid	 High Speed Rail
 Wireless Charger	 Data Server	 EV Inverter	 Solar Inverter	 PV System	 Industry Drivers	 Ships & Vessels	
 Laptop Adapter	 Class D Audio	 Home Appliances	 Robotics	 UPS	 Energy Storage	 Welding	 Induction Heating

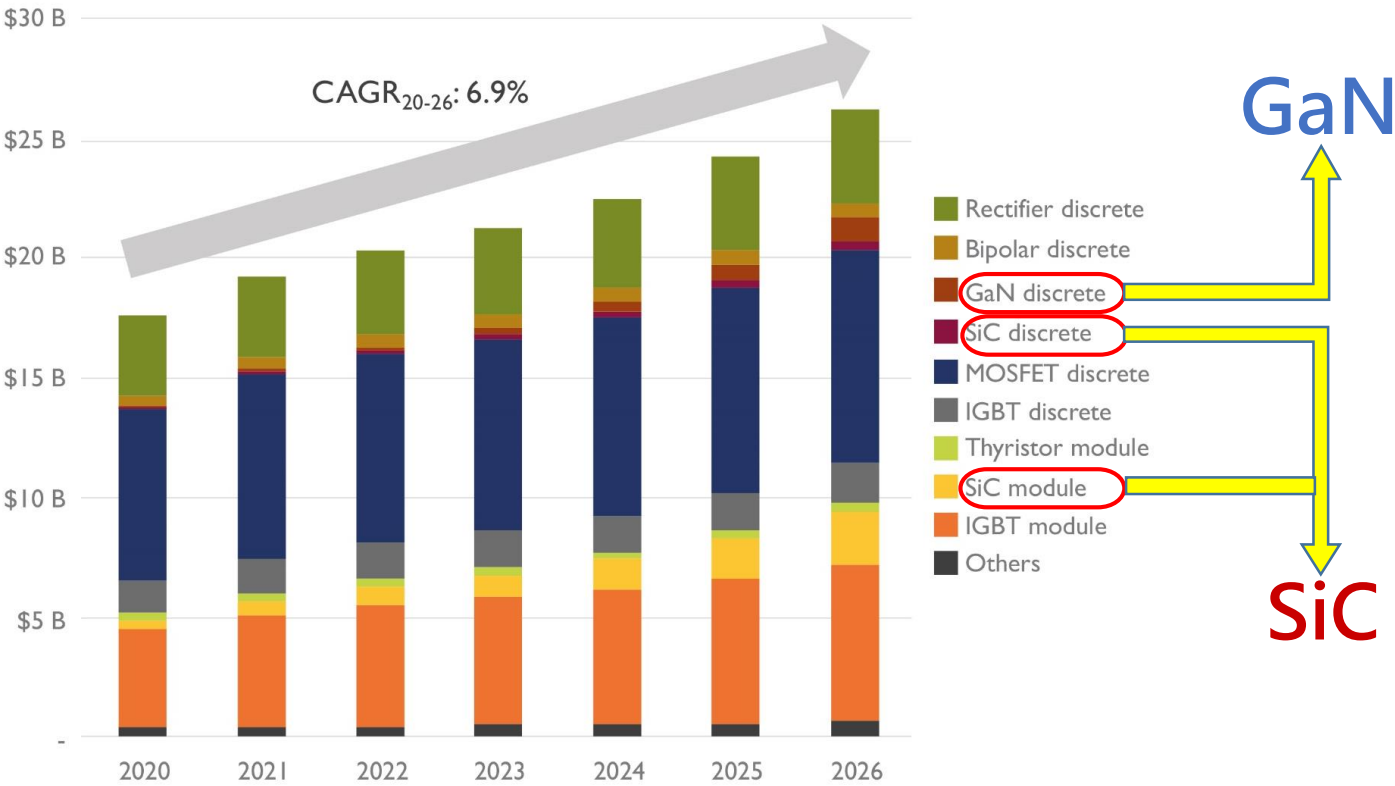


GaN

SiC

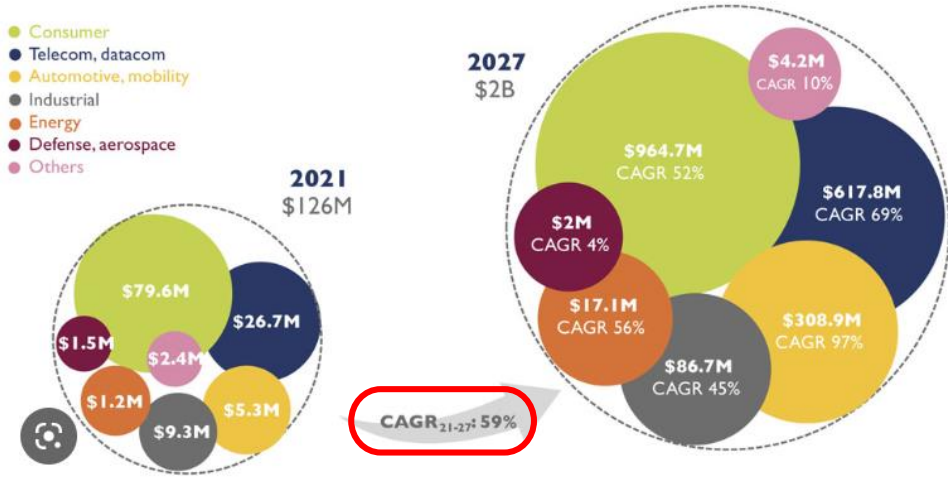
功率元件市場分析

(Source: Status of the Power Electronics Industry 2021 report, Yole Développement, 2021)



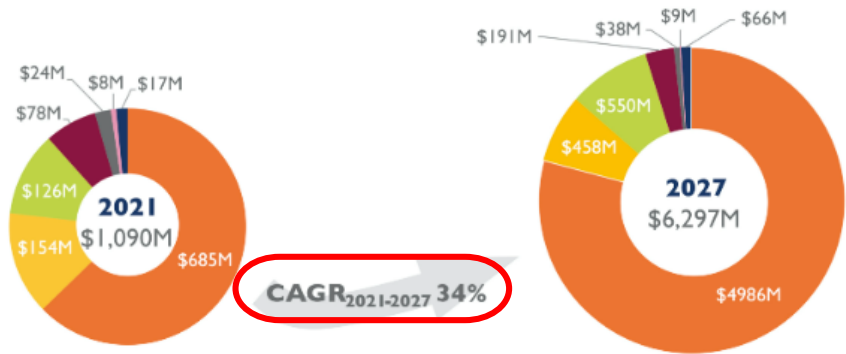
2021-2027 power GaN device market revenue

(Source: Power GaN 2022 report, Yole Développement, 2022)

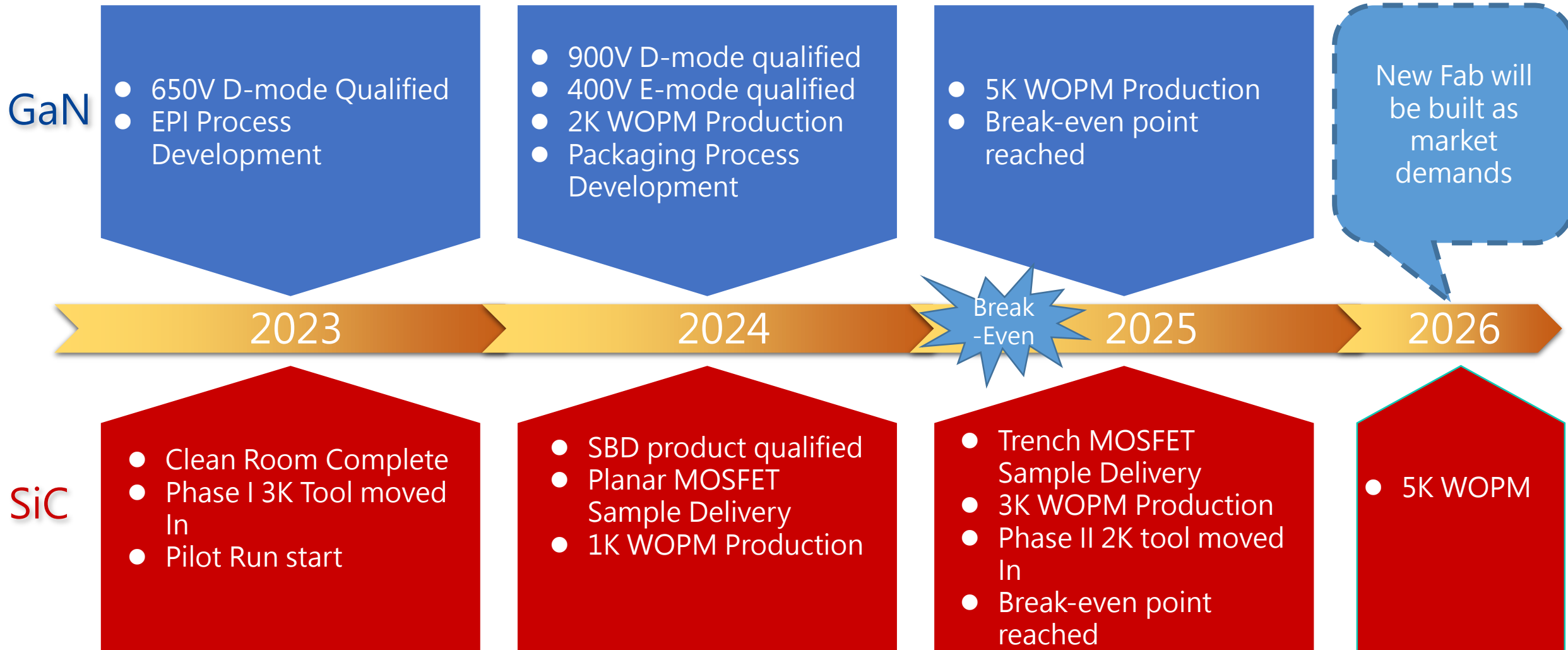


2021-2027 power SiC market devices split by segment

(Source: Power SiC 2022 report, Yole Développement, 2022)

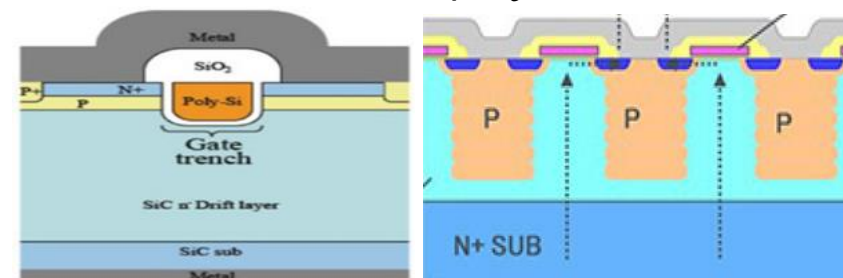


新產品開發里程碑

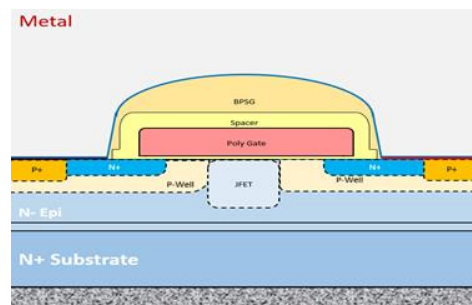


積亞半導體發展碳化矽技術藍圖

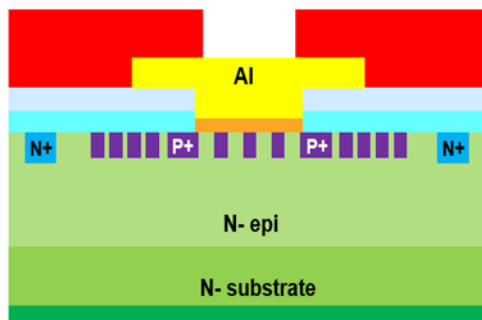
New Technologies:
Trench, Superjunction



SiC-MOSFET
(Planar Power MOSFET)



SiC-Diodes
(SBD/JBS/MPS)

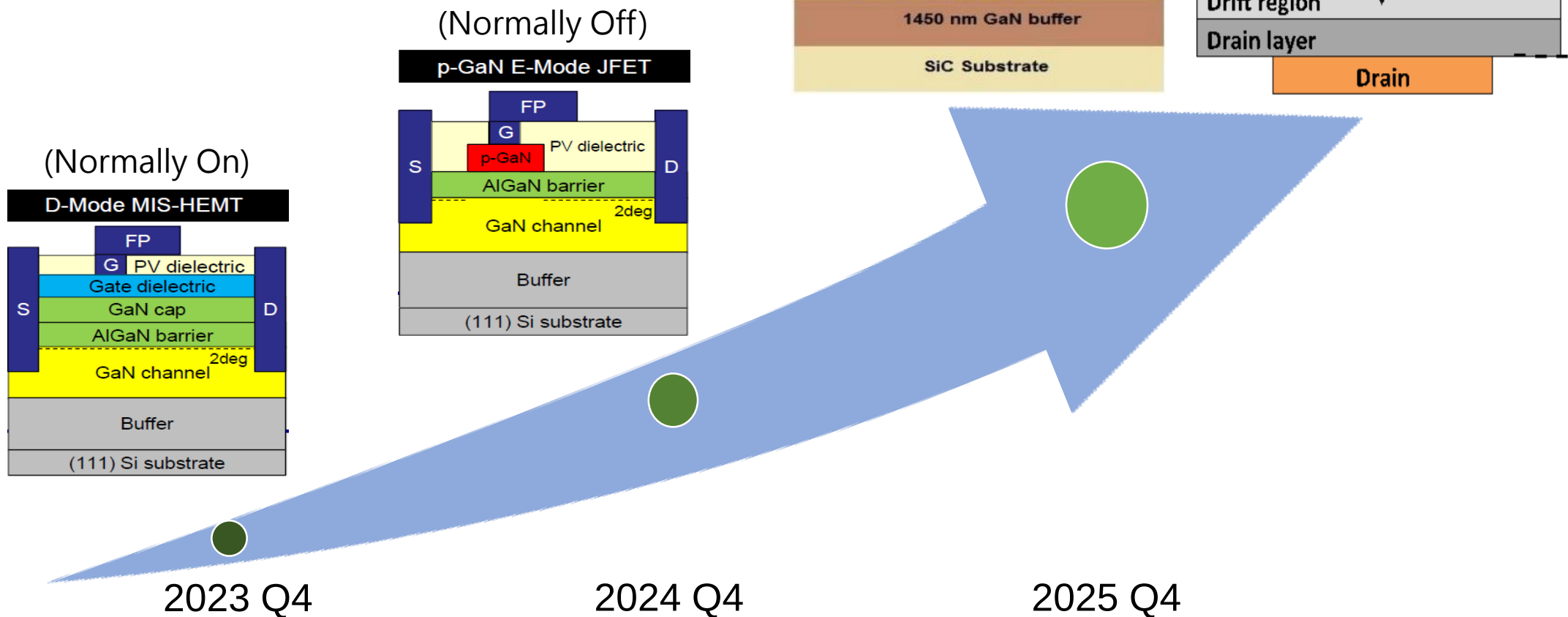


2024 Q4

2025 Q4

2026 Q4

台亞半導體發展氮化鎵技術藍圖



- 台亞半導體將在發射與感測元件市場持續推出更具競爭力的產品。
- 因應市場及客戶需求，台亞集團將增加投資功率半導體元件及模組生產。特別是在寬能隙GaN及SiC半導體項目，使產品組合更加多樣化，並提高市佔率。
- 現有感測元件與GaN/SiC功率元件的綜合效應，將創造出多種新產品，並在現有產能內極大化營業額與毛利率。

Q & A